



2021年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2020年12月24日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <https://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 2021年1月14日 配当支払開始予定日 2021年2月3日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年5月期第2四半期の業績(2020年6月1日～2020年11月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年5月期第2四半期	43,096	△8.7	3,210	1.7	3,166	5.2	2,160	4.3
2020年5月期第2四半期	47,187	0.2	3,156	4.8	3,010	0.9	2,070	1.0

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年5月期第2四半期	67.26	—
2020年5月期第2四半期	64.46	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年5月期第2四半期	91,557	65,228	71.2
2020年5月期	101,576	63,541	62.6

(参考)自己資本 2021年5月期第2四半期 65,228百万円 2020年5月期 63,541百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年5月期	—	16.00	—	16.00	32.00
2021年5月期	—	16.00	—	—	—
2021年5月期(予想)	—	—	—	17.00	33.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年5月期の業績予想(2020年6月1日～2021年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	84,000	△8.8	6,000	1.2	5,900	4.9	4,040	4.3	125.76

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年5月期2Q	35,497,183株	2020年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2021年5月期2Q	3,371,680株	2020年5月期	3,371,224株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年5月期2Q	32,125,686株	2020年5月期2Q	32,126,484株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続きましたが、経済活動が再開される中で、生産や個人消費に持ち直しの動きが見られました。

当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は回復基調に転じたものの、全体の投資動向としては引き続き慎重な姿勢が見られました。一方で、半導体シリコンウエハーの生産は、コロナ禍の中でも概ね堅調に推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は430億9千6百万円と前年同四半期比8.7%の減収となりましたが、営業利益は32億1千万円(前年同四半期比1.7%増)、経常利益は31億6千6百万円(同5.2%増)、四半期純利益は21億6千万円(同4.3%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、300mmウエハー(再生ウエハーを含む)を中心に生産は概ね堅調に推移し、前期第4四半期を底として売上は増加傾向にあります。そうした中で、更なる品質の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、ともに減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の減少等により、前事業年度末と比較して100億1千9百万円減少し、915億5千7百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により117億6百万円減少し、263億2千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加16億4千6百万円等により、652億2千8百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は117億3千4百万円となり、前事業年度末に比べ5億9千8百万円の減少となりました。営業活動の結果得られた資金は116億9千8百万円となりました。これは仕入債務の減少31億3千万円等による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益31億6千6百万円、減価償却費83億1千9百万円等により資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は117億3千1百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出116億6千1百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用した資金は5億6千4百万円となりました。これは配当金の支払5億1千3百万円等があったことによるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が世界経済に与える影響などが懸念されるものの、わが国経済は経済活動の再開や各種経済対策の効果により、緩やかに持ち直しの動きが続くものと予想されます。

そうした中で半導体業界におきましては、人工知能(AI)や次世代通信規格(5G)の普及などに伴う半導体需要の増加が中長期的に見込まれております。

このような経営環境のもと、当社といたしましては、より高精度かつ生産性の高い加工プロセスを確立し競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

なお、未定としておりました2021年5月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高840億円、営業利益60億円、経常利益59億円、当期純利益40億4千万円を見込んでおります。

また、期末配当金につきましては、中間配当金に比べ1円増配の1株につき17円とする予定であります。これにより、当期の年間配当金は前期に比べ1円増配の1株当たり33円となります。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,333	17,734
受取手形及び売掛金	27,308	24,729
商品及び製品	1,053	263
仕掛品	1,007	656
原材料及び貯蔵品	2,398	2,332
その他	1,029	521
貸倒引当金	△4	△2
流動資産合計	51,126	46,234
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	23,545	23,260
機械及び装置(純額)	16,397	14,807
その他(純額)	7,365	4,261
有形固定資産合計	47,308	42,329
無形固定資産		
投資その他の資産	1,135	1,049
その他	2,007	1,944
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	2,006	1,944
固定資産合計	50,450	45,322
資産合計	101,576	91,557
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,284	17,154
短期借入金	100	50
未払法人税等	387	1,106
引当金	151	111
その他	16,096	6,964
流動負債合計	37,020	25,387
固定負債		
退職給付引当金	849	775
その他	165	165
固定負債合計	1,015	941
負債合計	38,035	26,328

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	30,648	32,294
自己株式	△4,767	△4,768
株主資本合計	63,482	65,128
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	58	86
繰延ヘッジ損益	0	13
評価・換算差額等合計	58	100
純資産合計	63,541	65,228
負債純資産合計	101,576	91,557

(2) 四半期損益計算書
(第2四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
売上高	47,187	43,096
売上原価	41,749	37,832
売上総利益	5,438	5,263
販売費及び一般管理費	2,281	2,053
営業利益	3,156	3,210
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	8	7
固定資産売却益	1	20
その他	14	17
営業外収益合計	26	45
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	163	75
その他	8	14
営業外費用合計	172	89
経常利益	3,010	3,166
税引前四半期純利益	3,010	3,166
法人税、住民税及び事業税	1,192	949
法人税等調整額	△253	56
法人税等合計	939	1,005
四半期純利益	2,070	2,160

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	3,010	3,166
減価償却費	9,411	8,319
受取利息及び受取配当金	△10	△8
支払利息	0	0
為替差損益(△は益)	0	1
売上債権の増減額(△は増加)	△1,609	2,579
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,121	1,207
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,507	△3,130
その他	566	△188
小計	11,983	11,945
利息及び配当金の受取額	10	8
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△1,038	△255
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,955	11,698
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	6,000	6,000
有形固定資産の取得による支出	△10,125	△11,661
有形固定資産の売却による収入	13	19
無形固定資産の取得による支出	△120	△32
その他	△111	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,342	△11,731
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△50	△50
配当金の支払額	△481	△513
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532	△564
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	79	△598
現金及び現金同等物の期首残高	11,415	12,333
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,494	11,734

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第2四半期累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,122	24,064	—	47,187	—	47,187
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	66	2,285	2,354	△2,354	—
合計	23,124	24,130	2,285	49,541	△2,354	47,187

当第2四半期累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,000	20,095	—	43,096	—	43,096
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	296	1,950	2,248	△2,248	—
合計	23,002	20,392	1,950	45,345	△2,248	43,096